

[RK3066_ANDROID4.1.1-SDK_V1.00_20120802]

Patch_V1.2 发布说明

目 录

目 录..... 2

一、补丁说明..... 3

 表 1 Patch_V1.2 与单独发布的专项补丁关系..... 3

二、更新内容..... 4

 表 2 Patch_V1.2 修复模块、源码路径及补丁目录..... 4

三、相关文档说明..... 5

四、 注意事项..... 5

 举例 1 5

 举例 2 5

一、补丁说明

[RK3066_ANDROID4.1.1-SDK_V1.00_20120802]Patch_V1.2 是针对 RK3066 4.1 平台的补丁包，适用前提为：

RK3066_ANDROID4.1.1-SDK_V1.00_20120802 加上

[RK3066_ANDROID4.1.1-SDK_V1.00]Patch_V1.0 补丁的工程。

表 1 Patch_V1.2 与单独发布的专项补丁关系

补丁包	V1.2 是/否包含
[RK3066_ANDROID4.1.1-SDK_V1.00] SD_Patch_V1.0.7z	是
[RK3066_ANDROID4.1.1-SDK_V1.00] DDR_Patch_V1.00.7z	是
[RK29&RK30-Android4.1.1-SDK] 以太网设置_Patch_V1.0.7z	是
[RK30xx_ANDROID4.1.1-SDK] 语音平板_Patch_V1.1.7z	否
[RK29&RK30-Android4.0.4&4.1.1-SDK] 3G_Patch_V2.2.7z	否
[RK29&RK30-Android4.0.4&4.1.1-SDK] 3G_Patch_V2.1.7z	是
[RK3066 & RK29XX Android 4.0.x & 4.1.1] RK901 Patch_V1.0.7z	是
[RK3066 & RK29XX-Android 4.0.x & 4.1.1-SDK] RK903&RK901WIFI 驱动_Patch_V1.0.7z	是
[RK30xx_ANDROID-SDK] linux-nand-driver_Patch_V1.4.zip	是

附 1：上表中《以太网设置_Patch_V1.0》可能与本补丁包不一致，以本补丁包为准。

附 2：[RK3066_ANDROID4.1.1-SDK_V1.00]Patch_V1.1 由于部分原因，没有对外发布。

二、更新内容

本次 SDK 补丁包对系统显示、音视频解码、浏览器、Flash 播放器、3G 模块、开机动画等模块的 BUG 进行了修复，更新了 NandFlash、Mali、WiFi 等模块的驱动，同时，解决了部分 CTS 测试 BUG，新增了部分固件工厂功能接口，系统整体稳定性得到进一步增强。

补丁包提供全部修改文件源码，也提供具体修改对比文件。由于修改内容较多，为简化打补丁的过程，建议一次性导入本补丁包的源码；然后，对有交叉修改的文件，进行手动合并，详见章节四。打补丁时，请参阅 readme 说明文档。

表 2 Patch_V1.2 修复模块、源码路径及补丁目录

修复模块	源码目录	补丁目录
ANDROID		
Recovery	bootable/recovery	src\android
CTS	build/target/product	
音视频	frameworks/av/include/media/ frameworks/av/media/ frameworks/av/services/audioflinger/ frameworks/base/media/	
库、APK、脚本等	device/rockchip/rk30sdk/	
开机动画	frameworks/base/cmds/bootanimation	
显示	frameworks/base/core/java/android/view frameworks/native/libs/gui frameworks/native/services/surfaceflinger	
浏览器	frameworks/base/core/java/android/webkit packages/apps/Browser/	
SystemUI	frameworks/base/packages/SystemUI	
Settings	packages/apps/Settings	
蓝牙	system/bluetooth/	
KERNEL		
驱动模块	源码目录	补丁目录
Sensors	drivers/input/	src\kernel
SD 卡	drivers/mmc	
3G	drivers/misc/3g_module	
USB	drivers/usb/	
显示	drivers/video/display/ drivers/video/logo drivers/video/rockchip	

codec	sound/soc/codecs/ sound/core/	
-------	----------------------------------	--

三、相关文档说明

补丁文件夹中包含 readme 文本及 doc 和 src 两个目录。readme 文件为本补丁包的总体说明文档；doc 目录下为补丁相关文档，包括补丁发布说明，补丁修改文件列表及 Patch 文件等；src 目录为补丁修改的全部源码及 patch 文件等。

打补丁前，请先仔细参阅说明文档。

四、注意事项

本次补丁内容较多，可以采取补丁源码覆盖的方式一次性导入，简化打补丁的过程。但部分工程文件，可能项目中有做定制修改，与补丁文件产生交叉修改的情况，此时需要客户进行手动合并。

建议，打补丁前事先备份项目中的定制化修改，如可将项目中的修改生成 patch 文件。然后导入补丁源码，再对照之前的备份修改文件，进行手动合并。

举例 1：项目中往往会对 android 层 `device/rockchip/rk30sdk/device.mk` 进行部分的修改，而本补丁中也对该文件进行了修改。此时可以采取如下方式处理：

- (1)，将项目中的修改内容备份下来；
- (2)，导入补丁文件，覆盖项目的源文件；
- (3)，手动加入之前的备份修改；

举例 2：项目中往往会对 kernel 层 `arch/arm/mach-rk30/board-rk30-sdk.c` 文件进行修改，或者自己生成新的 board 文件，而本补丁中也对 board 文件进行了修改，具体修改内容见补丁目录 `src\kernel\board-src\patch` 中的 patch 文件。此时可采取如下方式处理：

- (1)，备份项目中对 board 文件的修改；
- (2)，对比补丁中的 board 文件，参照 Patch 文件进行手动合并；

(3)，如项目中未修改 board 文件，使用的也是 `board-rk30-sdk.c` 文件，则可直接用补丁源文件进行覆盖。